



# 2009年3月期 決算説明会

2009年5月25日

**ワイエイシ株式会社**



# 次 第

---

1. ご挨拶と会社概要・・・・・・・・・・・・ 代表取締役社長  
百瀬 武文
2. 決算の概要・・・・・・・・・・・・ 管理本部経理部長  
古橋 博
3. 2009年度の事業計画・・・・・・・・・・・・ 代表取締役社長  
(第10次中期計画概要) 百瀬 武文
4. 質疑応答



# 本日のキーメッセージ

- 高収益企業文化を構築しながら規模の拡大をめざす（第10次中期計画）。
  - ・事業体質の強化
  - ・さらなる成長に向けての挑戦
  
- 太陽電池事業が加わりました。



# 1. 会社概要



## 1-1 基本情報

(2009年5月25日現在)

商号	ワイエイシイ株式会社
証券コード	6298 (東証1部)
設立	1973年(昭和48年)年5月
代表者	代表取締役社長 百瀬武文
事業所等	本社：東京都昭島市武蔵野3-11-10 営業所：大阪、大分、昭島、新竹(台湾)、上海(中国) 工場：昭島、山梨、熊本、大分
グループ会社	ワイエイシイ新潟精機株式会社(新潟県妙高市) HYAC Corporation(米国) YAC Systems Singapore Pte Ltd(シンガポール)
投資会社	株式会社NDマテリアル 篠田プラズマ株式会社
資本金	2,756百万円
事業内容	産業用エレクトロニクス関連装置、クリーニング関連装置の開発・製造・販売
決算	3月31日



## 1-2 当社の主力製品

### ▲ハードデスク関連

- ・バニッシャー装置
- ・ワイピング装置
- ・クリーンコンベア

### ▲液晶関連

- ・プラズマ・ドライ・エッチング装置
- ・プラズマ・ドライ・アッシング装置
- ・アニール装置

### ▲半導体関連

- ・ロジック系IC用テストハンドラー

### ▲クリーニング関連

- ・自動包装機
- ・ワイシャツ仕上げ機
- ・アパレル

### ▲FEL関連

- ・FEL用エミッターの製作

### ▲太陽電池関連

- ・テクスチャリング装置
- ・拡散炉
- ・ISO/PSG装置
- ・AR成膜装置
- ・洗浄機

## <ハードディスク関連製品>

バニッシャー	ハードディスク製造工程において、ディスクに磁性体を生成後、表面のナノオーダーの微小突起を除去する精密研磨装置
ワイピング	ハードディスク製造工程において、ディスクに磁性体を生成後、バニッシュ工程の前後で、表面のパーティクルの除去及び潤滑財を表面に均一にする装置
クリーンコンベア (HD工場向け)	モジュールの組み合わせで自由な搬送ライン設計が可能なローラー式コンベアAGV(自走型搬送ロボット)やOHT(天井架設型搬送装置)に比べ、搬送物をいつでも搬送ラインに投入することができ、搬送効率が高い。
クリーンコンベア (半導体工場向け、 太陽電池工場向け)	(同上)但し、半導体向けは搬送物が300mm用ウエハポット、太陽電池はガラス基板又は約5"ウエハーが入ったカセットで、ハードディスク用に比べコンベア幅大きく、より高い耐加重性、耐衝撃性、高速搬送が要求される。
クリーンコンベア (液晶工場向け)	(同上)但し、搬送物はパネルサイズに切りだされた基盤を搬送する、ハードディスク用に比べコンベア幅大きく、より高い耐加重性、耐衝撃性、高速搬送が要求される。



バニッシャー



ハードディスク用クリーンコンベア



半導体用クリーンコンベア

## <液晶関連製品>

プラズマ・ドライ・エッチング  
装置

液晶ディスプレイの各セルの液晶整列方向を個々に制御する微小トランジスターをガラス基板上に描画するプロセスで用いる。  
フォトマスクを通して露光した結果、硬化した部分以外を除去後、露出した薄膜をプラズマを利用してガス化し除去する装置。



第7世代用プラズマ・ドライ・エッチング装置(3チャンバータイプ)

対応  
基板サイズ

G2  
G4  
G4.5  
G5  
G5.5  
G6  
G7  
G7.5  
G8



## <半導体関連製品>

ロジック系IC用  
ICテストハンドラー

ICのパッケージング後の検査工程で、テスターと接続して使用し、テスターからのテスト結果信号に基づき、ICを良品と不良品に自動選別する装置。  
必要に応じて、精度の高い高温・低温(-55°C~155°C)下でのテストも行う。



ICテストハンドラー(4個同時測定・常温タイプ)



新製品 ICテストハンドラー(16個同時測定・常・高温タイプ)

## <クリーニング関連製品>

ボディープレス機せ	シャツを前後から熱版ではさみシャツのボディー部をプレスする装置。 胴立を2つもち、プレス中に次のシャツを装填できるダブルタイプと、胴立がひとつのシングルタイプがある。 またプレス完了のシャツを自動でハンガーの掛けるオートキャリー付のタイプもあり。
タック・スリーブプレス機	シャツのタック部・袖部のプレス機(ダブルタイプ・シングルタイプ)
カラー・カフスプレス機	シャツの襟部・カフス部のプレス機(ダブルタイプ・シングルタイプ)
包装機	クリーニング完了後の衣類にカバーフィルムを自動で装填する装置。 ハンガーのままカバーする立体タイプとたたんだ状態でカバーする平面タイプがある。
アパレル関連機械	洋服の生産工程、縮絨機(生地を蒸気で安定化させる)、芯地・接着機(裁断後の生地を張り合わせる) プレス仕上げ機(完成商品のシワを取り成型する)



シャツ用ボディープレス機  
(Wタイプ・オートキャリー付)



包装機 (立体タイプ)



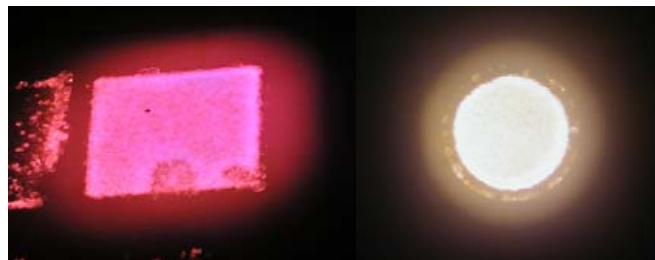
縮絨機



仕上げ機

## <FEL関連商品>

ナノダイヤモンド薄膜製造	<p>金属等の材料の表面にナノダイヤモンドの薄膜を生成したエミッターを製作。</p> <p>特徴</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・従来の蛍光灯と異なり、水銀・鉛等の有害物質を使用しない。</li><li>・LED(発光ダイオード)に比べ発光効率が高く省エネ効果がある。</li><li>・蛍光灯に比べ長寿命である。</li><li>・蛍光灯、LEDに比べ発熱量が少ない。</li><li>・色合成の自由度が高い。</li></ul>
--------------	---



発光写真

## <太陽電池関連商品>

### 太陽電池(結晶・多結晶)製造装置

結晶・多結晶型太陽の全ライン(インライン・バッチ方式)の製作。

#### 特徴

- ・テクスチャリング (バッチ・インライン装置)。
- ・拡散炉 (P塗布装置・チューブ(バッチ)式・インライン装置)。
- ・PSG(ISO) (バッチ・インライン装置)。
- ・反射防止膜(AR)成膜 (PECVD装置)。
- ・配線印刷 (スクリーン印刷/乾燥炉)。
- ・配線形成(BSF形成) (焼成炉)
- ・その他関連装置





## 2. 決算の概要



## 2-1 決算のハイライト(連結)

単位 百万円

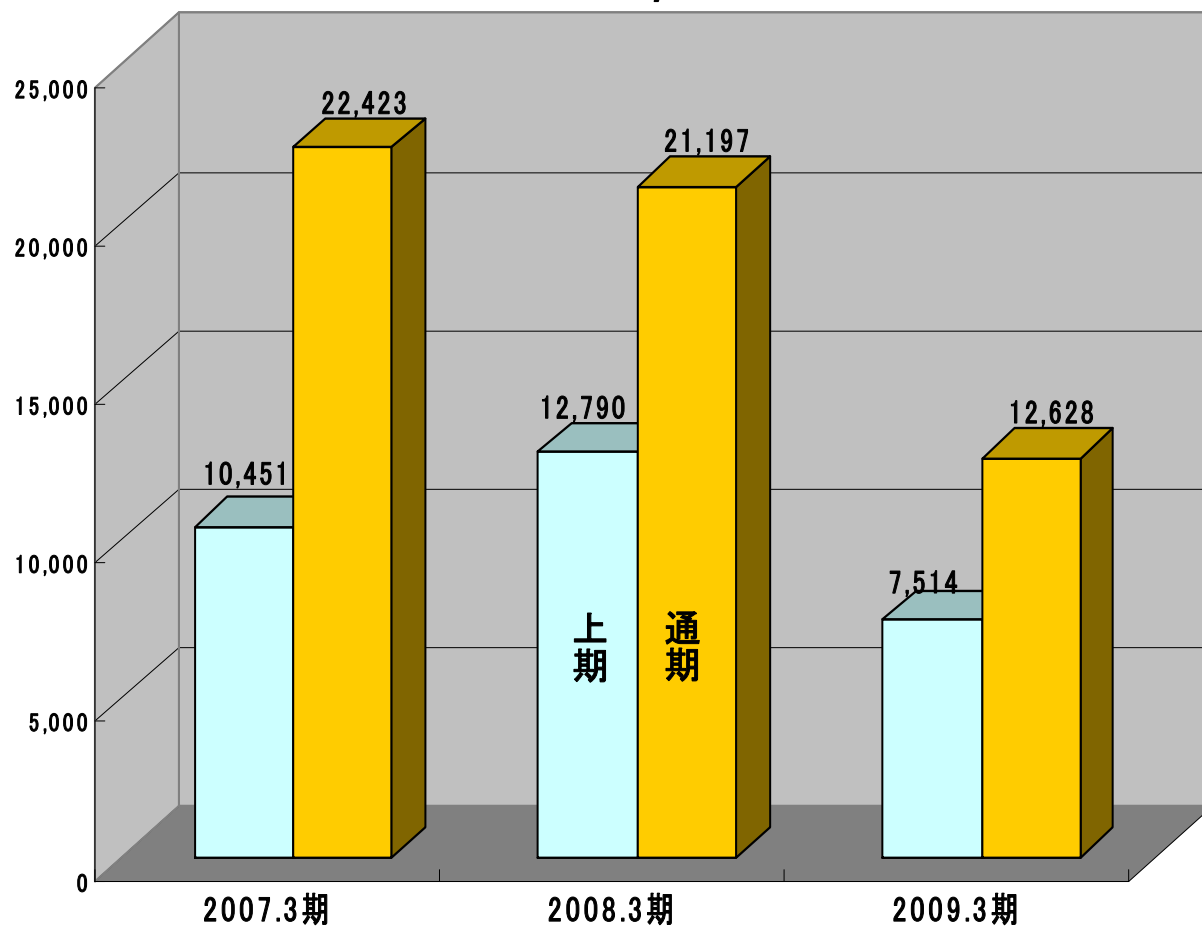
科目	2007年 3月期	2008年 3月期	2009年 3月期	対前年 増減額	対前年比 増減率(%)
売上高	22,423	21,197	12,628	▲8,569	▲40.4%
メモリーデスク	9,899	7,039	2,238	▲4,801	▲68.2%
液晶	9,400	10,919	7,609	▲3,310	▲30.3%
半導体	1,403	1,093	1,164	71	6.5%
クリーニング*	1,720	2,145	1,615	▲530	▲24.7%
FEL	—	—	1	—	—
営業利益	3,676	2,295	255	▲2,040	▲88.9%
経常利益	3,583	2,371	430	▲1,941	▲81.9%
当期利益	2,103	1,524	510	▲1,014	▲66.5%
1株当たり当期利益	219.1	158.1	54.8	▲103.3	▲65.3%
営業利益率	16.4%	10.8%	2.0%	—	—
研究開発費	236	287	310	23	8.0%
設備投資額	98	321	217	▲104	▲32.4%
減価償却実施額	159	148	183	35	23.6%



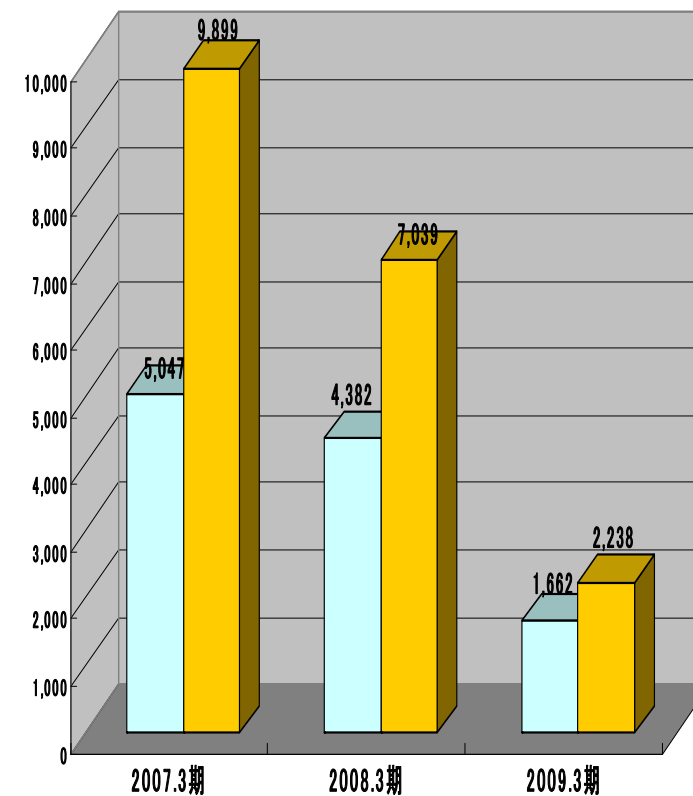
## 2-2 事業別売上金額(連結)

単位 百万円

### 全社



### メモリーデスク関連

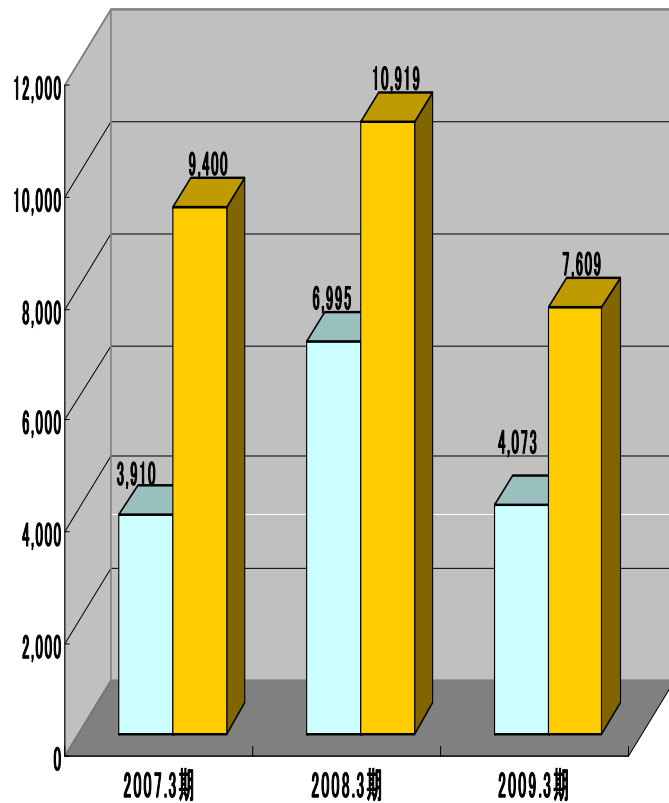




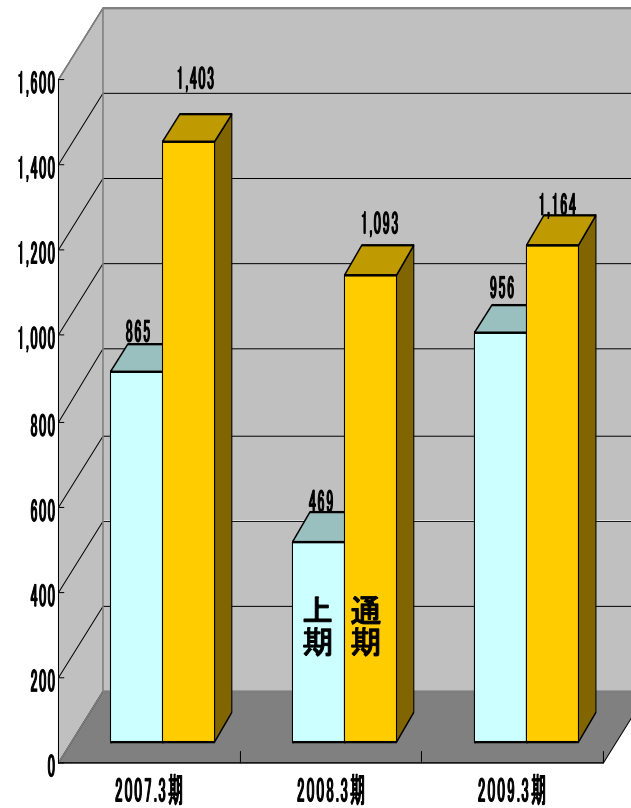
## 2-2 事業別売上金額(連結)

単位 百万円

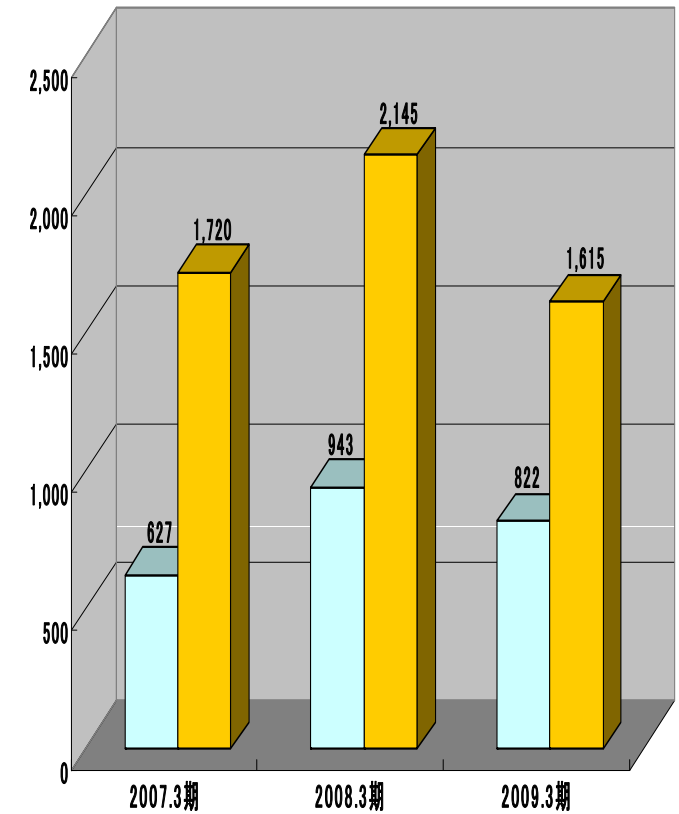
### 液晶関連



### 半導体関連



### クリーニング関連







## 2-3 事業別受注金額(連結)

単位 百万円

科目	2007年 3月期	2008年 3月期	2009年 3月期	対前年 増減額	対前年比 増減率(%)
メモリーディスク関連	9,582	5,105	1,667	▲3,438	▲67.3%
液晶関連	10,872	9,969	5,778	▲4,191	▲42.0%
半導体関連	1,367	1,337	773	▲564	▲42.2%
FEL	—	—	1	—	—
合計	21,822	16,412	8,220	▲8,192	▲49.9%

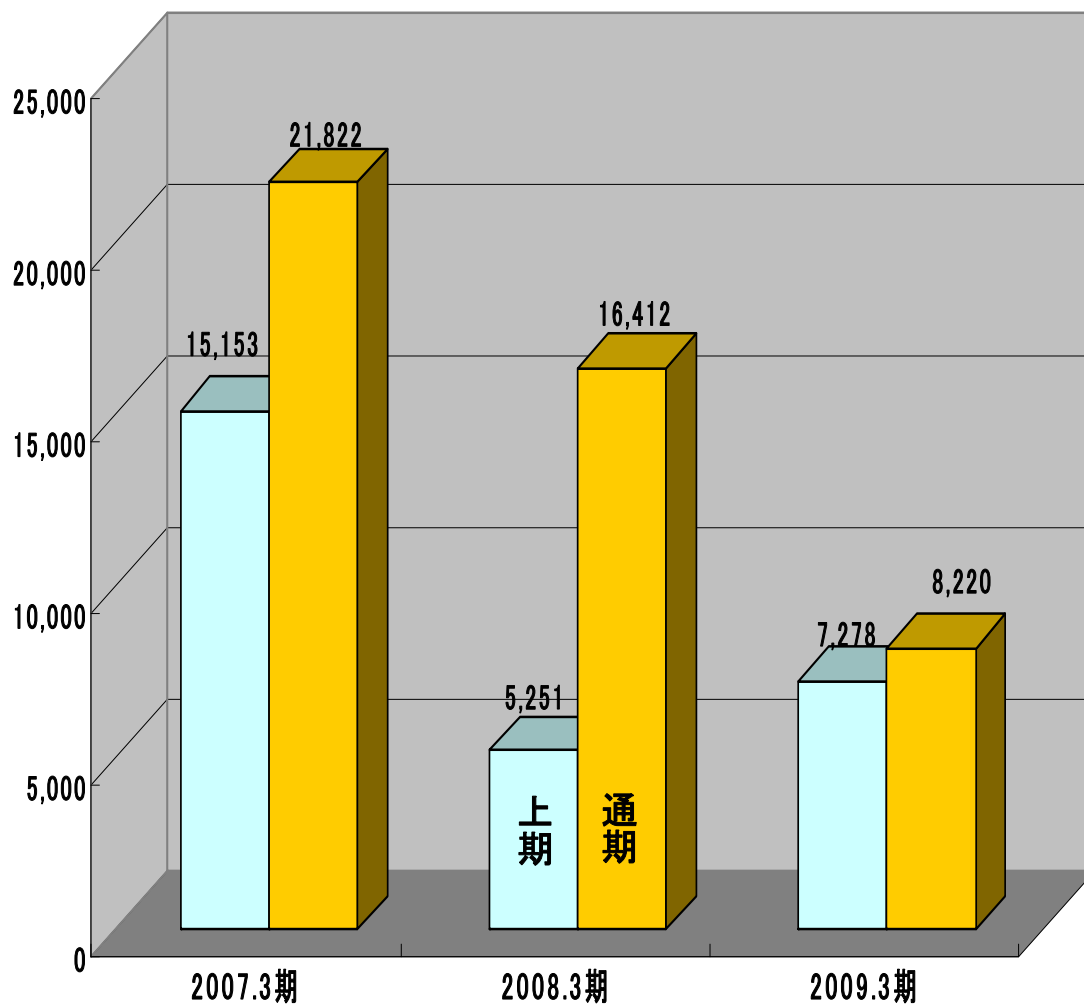
クリーニング関連事業については、販売計画に基づいた見込み生産を行っているため、受注高の表示を割愛しております。



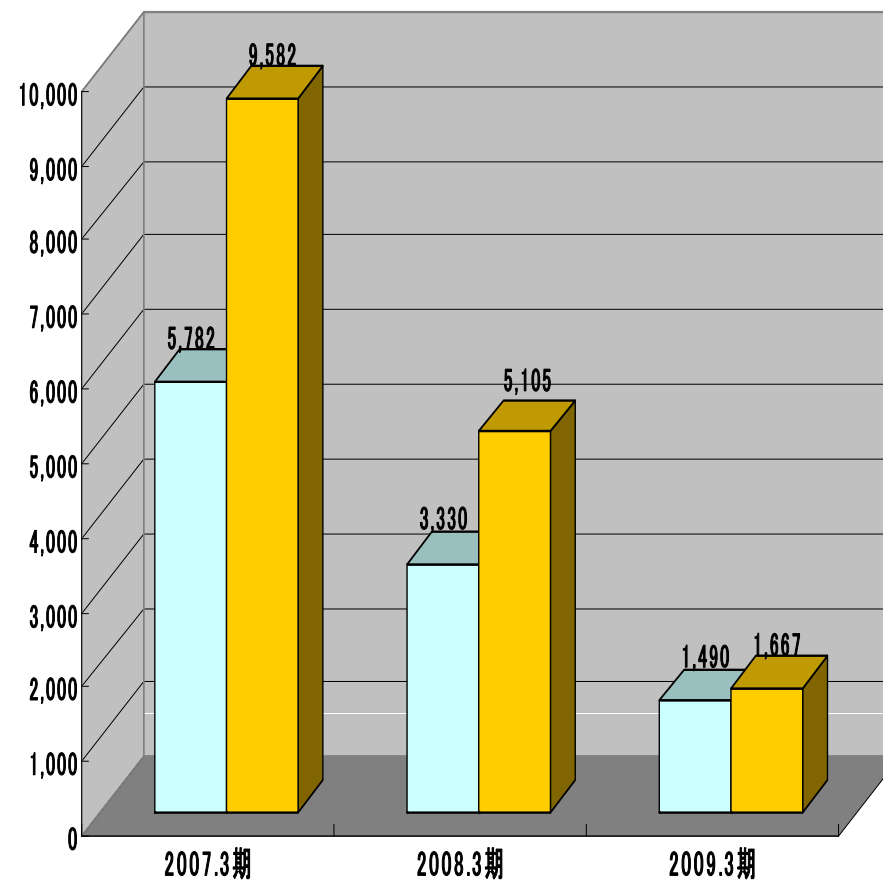
## 2-3 事業別受注金額(連結)

単位 百万円

### 全社



### メモリーデスク関連

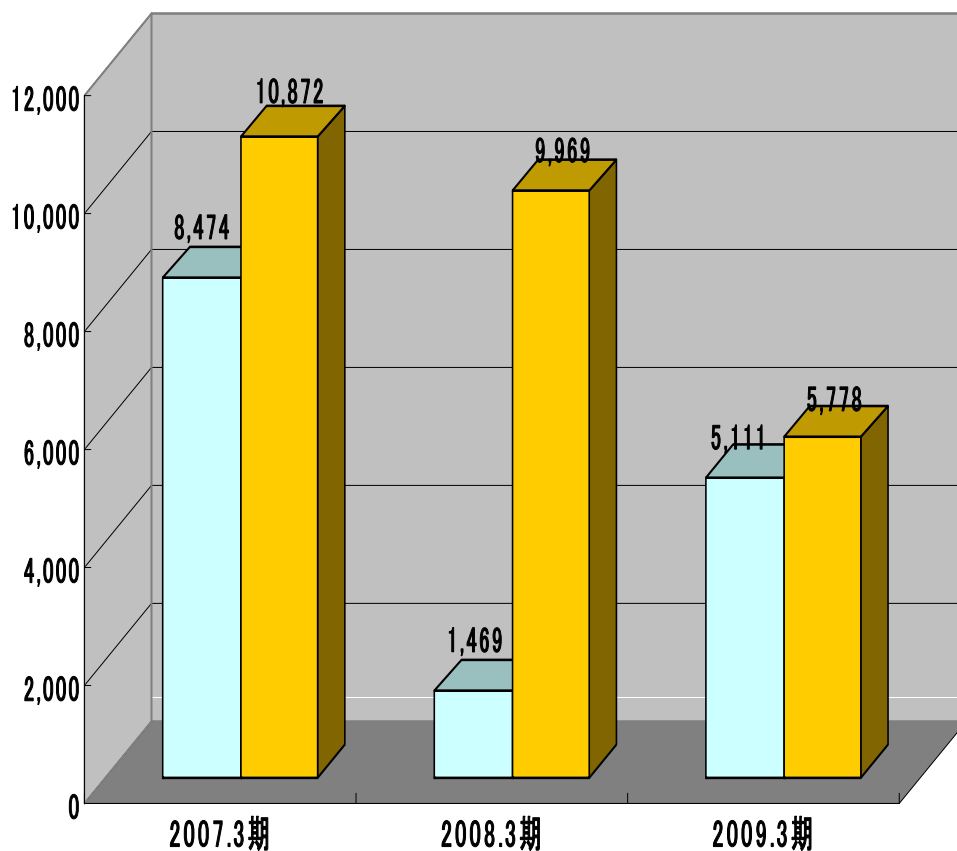




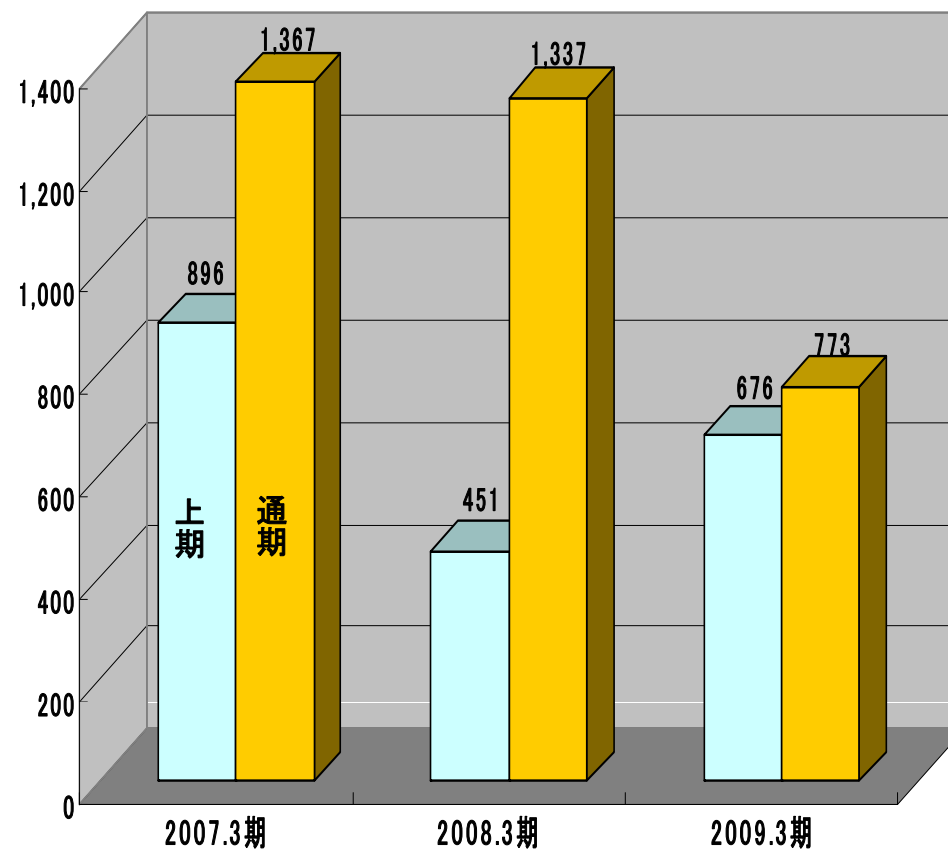
## 2-3 事業別受注金額(連結)

単位 百万円

### 液晶関連



### 半導体関連





## 2-4 事業部別受注残金額(連結)

単位 百万円

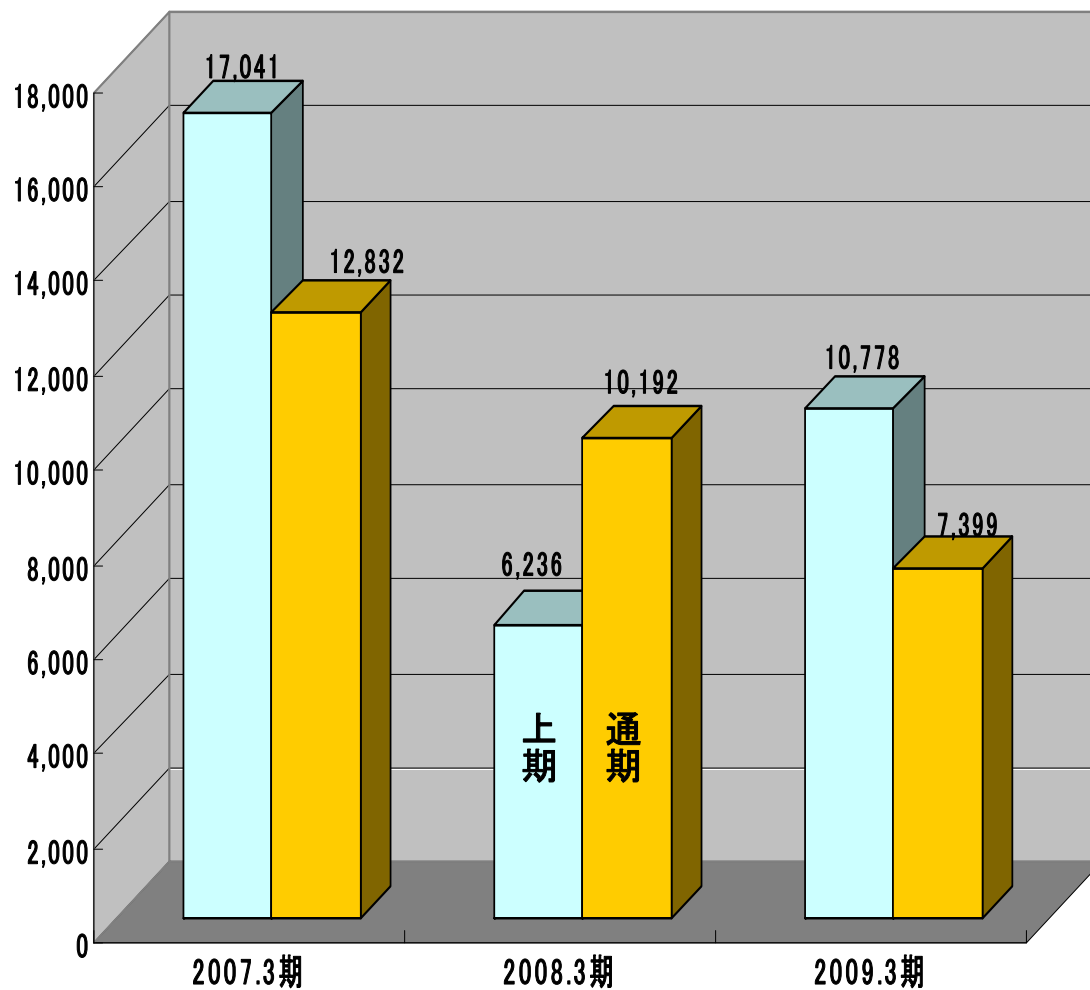
科目	2007年3月	2008年3月	2009年3月	対前年 増減額	対前年比 増減率(%)
メモリーデスク関連	2,795	862	291	▲571	▲66.2%
液晶関連	9,878	8,928	7,097	▲1,831	▲20.5%
半導体関連	157	401	10	▲391	▲97.5%
FEL	—	—	0	—	—
合計	12,832	10,192	7,399	▲2,793	▲27.4%



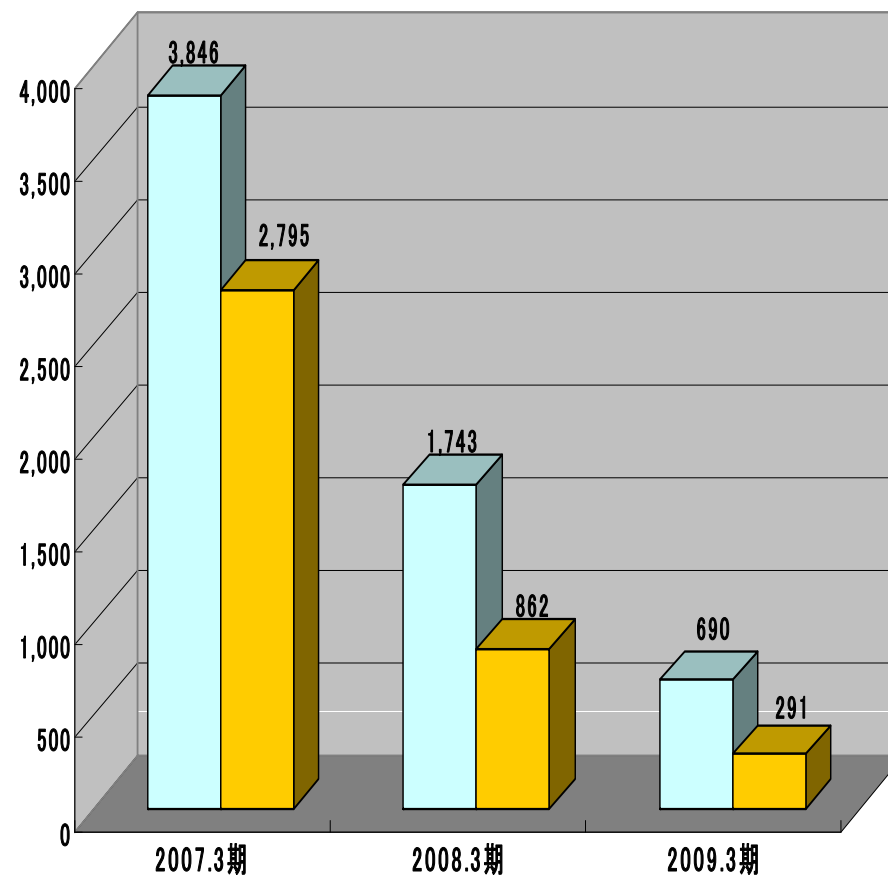
## 2-4 事業部別受注残金額(連結)

単位 百万円

### 全社



### メモリーデスク関連

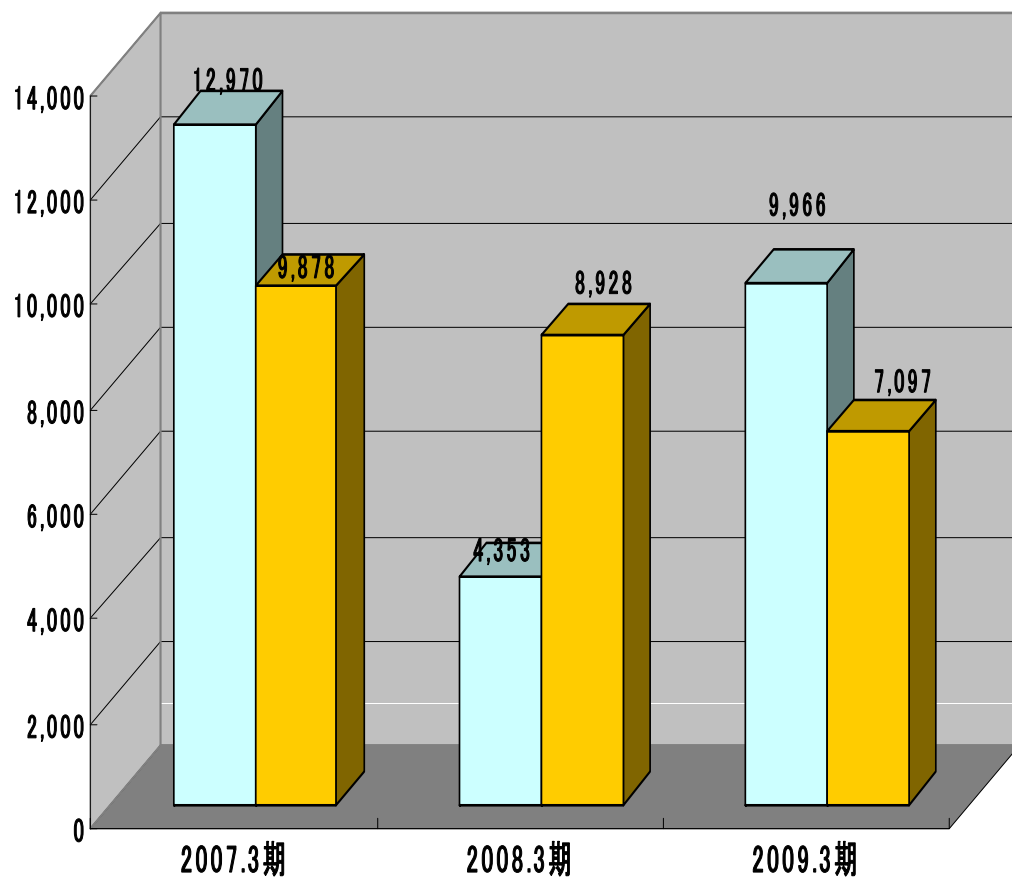




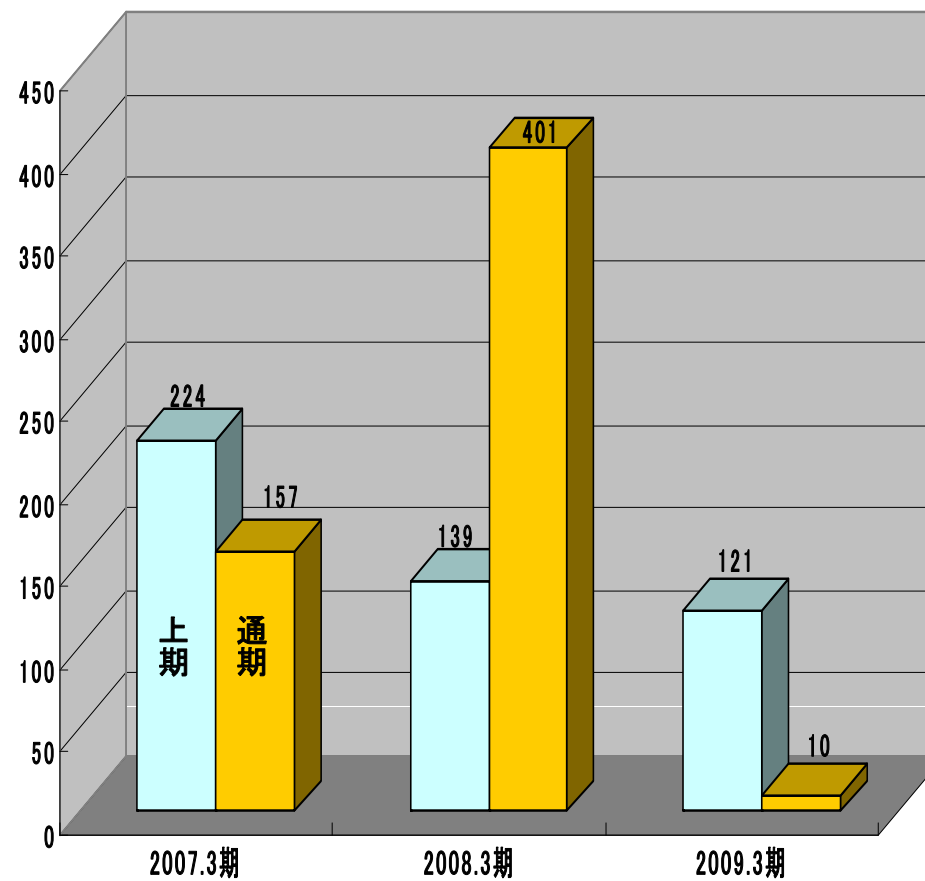
## 2-4 事業部別受注残金額(連結)

単位 百万円

### 液晶関連



### 半導体関連





## 2-5 損益計算書のレビュー(連結)

単位 百万円

科目	2007年 3月期	2008年 3月期	2009年 3月期	対前年 増減額	対前年比 増減率(%)
売上高	22,423	21,197	12,628	▲8,569	▲40.4%
売上原価	16,710	16,693	10,224	▲6,469	▲38.8%
売上総利益	5,712	4,503	2,403	▲2,100	▲46.6%
販管費	2,036	2,208	2,147	▲61	▲2.8%
営業利益	3,676	2,295	255	▲2,040	▲88.9%
営業外収益	73	169	243	74	43.8%
営業外費用	166	92	69	▲23	▲25.0%
経常利益	3,583	2,371	430	▲1,941	▲81.9%
特別利益	8	6	10	4	66.7%
特別損失	117	3	28	25	833.3%
税引前当期純利益	3,474	2,374	412	▲1,962	▲82.6%
法人税等	1,371	850	▲97	▲947	—
当期純利益	2,103	1,524	510	▲1,014	▲66.5%



## 2-6 貸借対照表のレビュー(連結)

単位 百万円

科目	2007年 3月期	2008年 3月期	2009年 3月期	対前年 増減額	対前年比 増減率(%)
流動資産	20,637	18,235	13,607	▲4,628	▲25.4%
現金預金	5,359	4,625	5,351	726	15.7%
売上債権	7,470	9,217	4,647	▲4,570	▲49.6%
棚卸資産	7,203	4,152	2,994	▲1,158	▲27.9%
その他	603	240	613	374	155.8%
固定資産	2,969	3,165	3,357	192	6.1%
有形固定資産	2660	2,827	2,842	15	0.5%
無形固定資産	109	99	88	▲11	▲11.1%
投資その他の資産	199	238	426	188	79.0%
資産合計	23,607	21,401	16,965	▲4,436	▲20.7%
流動負債	12,465	8,499	3,513	▲4,986	▲58.7%
仕入債務	9,199	4,133	2,443	▲1,690	▲40.9%
短期借入金	1,363	3,646	611	▲3,035	▲83.2%
その他	1,902	719	459	▲260	▲36.2%
固定負債	1,097	2,172	2,654	482	22.2%
社債・長期借入金	609	1,621	2,128	507	31.3%
その他	488	550	525	▲25	▲4.5%
負債合計	13,563	10,672	6,167	▲4,505	▲42.2%
純資産	10,044	10,729	10,797	68	0.6%
負債及び資本合計	23,607	21,401	16,965	▲4,436	▲20.7%





## 2-7 キャッシュフロー計算書のレビュー(連結)

単位 百万円

科目	2007年 3月期	2008年 3月期	2009年 3月期
営業活動によるCF	2,095	▲2,823	3,568
投資活動によるCF	▲91	▲306	▲11
財務活動によるCF	▲1,400	2,582	▲2,814
現金及び現金同等物の期末残高	5,335	4,621	5,344



### **3. 2009年度の事業計画 (第10次中期計画概要)**



# 3-1 第10次中期計画の基本戦略

第10次中期計画（2009年度～2011年度）

平成21年4月1日

## 高収益企業文化の構築と規模の拡大

(高収益企業文化の構築と規模の拡大へのバックアップ)

資材本部  
管理本部  
社長室  
内部監査室  
環境管理室



支援

<p><b>事業予算の達成</b></p> <p><b>事業部</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・メモリーディスク</li> <li>・半導体</li> <li>・プラズマシステム</li> <li>・クリーニング</li> <li>・FEL</li> <li>・太陽電池</li> </ul> <p><b>グループ会社</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・HYAC</li> <li>・YSS</li> <li>・YNS</li> </ul> <p><b>投資会社</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・(株)NDマテリアル</li> <li>・篠田プラズマ(株)</li> </ul>	<p><b>(1) 経営基本方針</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・高収益企業文化の構築</li> <li>・規模の拡大</li> <li>・デバイス事業の急拡大</li> <li>・グローバル経営</li> <li>・グリーンニューデール</li> <li>・内部体制強化</li> <li>・やりがい経営</li> </ul>
	<p><b>(2) 経営目標</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・売上500億円以上</li> <li>・営業利益率15%以上</li> <li>・新製品売上20%以上</li> </ul>
	<p><b>(3) 経営目標達成への事業戦略</b></p> <p><b>既存事業部</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・主力製品のシェアアップ（差別化）</li> <li>・取扱製品の増加（アライアンス）</li> <li>・グローバル展開の拡大（東南アジア）</li> <li>・サービス事業の拡大</li> <li>・依命システム</li> <li>・事業コスト</li> <li>・経営コスト</li> <li>・人材教育・モチベーション</li> </ul> <p><b>開発事業</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・開発のスピードUP</li> <li>・アライアンス</li> </ul> <p><b>M&amp;Aによる事業拡大</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・新事業の取込</li> <li>・シナジー効果</li> </ul>

## 3-2 2009年度事業活動の指針

---

(1) 当社を取巻く事業環境

(2) 21年度のキーワード

(3) 事業体質の強化

(4) 成長に向けての挑戦

### ① 高収益企業への挑戦（企業文化の構築）

- [1] 営業戦略
- [2] 低コスト事業（粗利率のUP）
- [3] 低コスト経営（固定費の圧縮）
- [4] 情報の共有化（高モチベーション）

### ② 事業規模の拡大

- [1] 既存事業
- [2] 新事業

### ③ 環境経営

### ④ その他



## 3-4 2009年度通期計画(連結)

単位 百万円

科目	2007年 3月期	2008年 3月期	2009年 3月期	2010年 3月期 (見込)		対前年 増減額 (見込)	対前年比 増減率(%) (見込)
				(上期)	(通期)		
売上高	22,423	21,197	12,628	2,500	11,000	▲1,628	▲12.9%
営業利益	3,676	2,295	255	▲400	300	45	17.6%
経常利益	3,583	2,371	430	▲420	250	▲180	▲41.9%
当期純利益	2,103	1,524	510	▲420	150	▲360	▲70.6%
1株当たり当期純利益 (円)	219.1	158.1	54.8	—	16.1	▲38.7	▲70.6%



## 3-4 事業別売上金額(連結)

単位 百万円

科目	2007年 3月期	2008年 3月期	2009年 3月期	2010年 3月期 (見込)		対前年 増減額 (見込)	対前年比 増減率(%) (見込)
				(上期)	(通期)		
メモリーディスク関連	9,899	7,039	2,238	700	2,300	62	2.8%
液晶関連	9,400	10,919	7,609	820	5,000	▲2,609	▲34.3%
半導体関連	1,403	1,093	1,164	200	700	▲464	39.9%
FEL関連	—	—	1	0	10	9	900.0%
太陽電池関連	—	—	—	45	1,300	—	—
クリーニング関連	1,720	2,145	1,615	735	1,690	75	4.6%
売上合計	22,423	21,197	12,628	2,500	11,000	▲1,628	▲12.9%



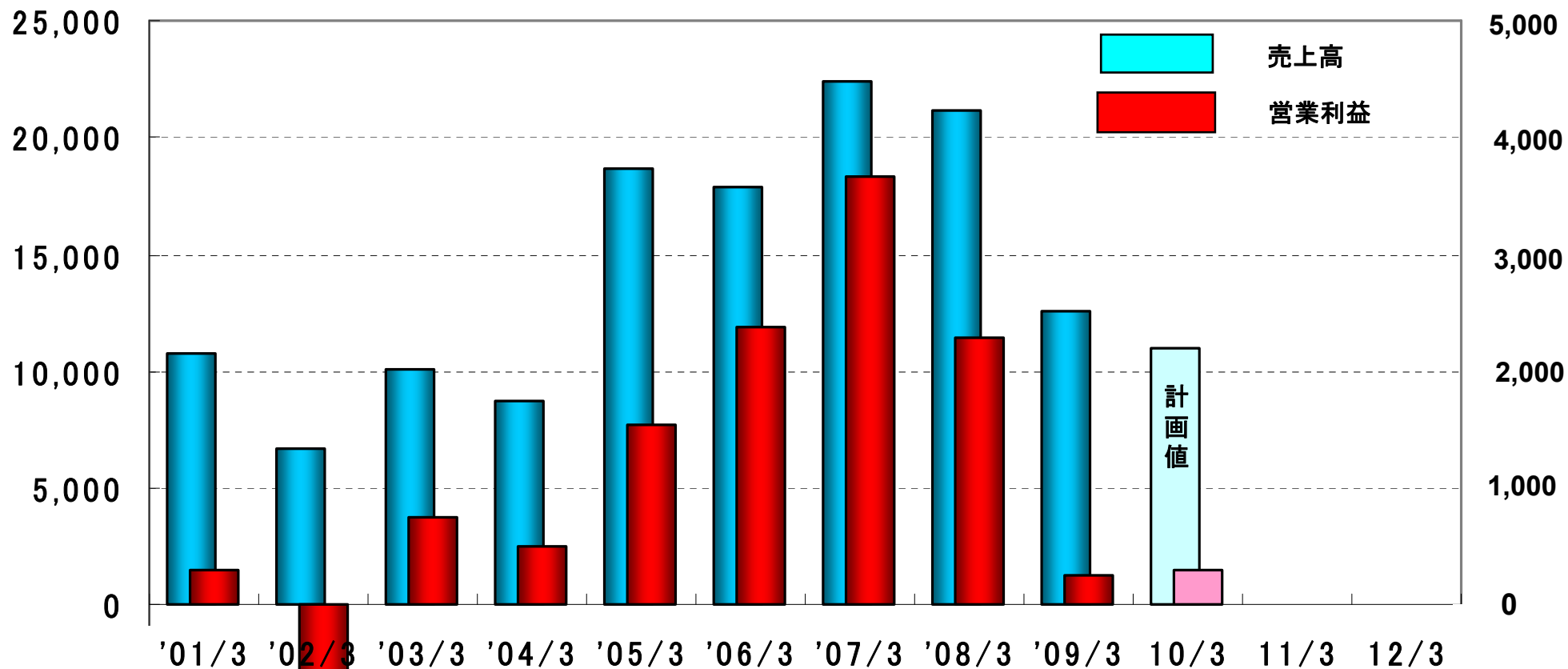
# 3-5 業績推移と第10次中期計画 (連結)

売上高

## 売上・営業利益実績

百万円

営業利益



第7次中期計画

第8次中期計画

第9次中期計画

第10次中期計画

V字回復

優良企業復

高収益企業挑戦

高収益企業文化の  
構築と規模の拡大





業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予数値と異なる可能性があります。

ワイエイシイ株式会社